

PC/ LED/ IC 自動化設備
解決方案

萬潤科技簡介

Presented by Allring

關於我們

創立時間

May 24, 1996

董事長

Larry Lu

資本額

833 Million

主要業務

專注於半導體、被動元件及LED製程之自動化機械設備

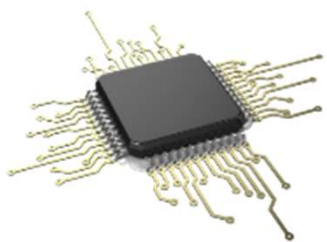


集團里程碑



1996

- 公司成立
- 發展被動元件領域設備
- 自動切割機
- 電感測試與包裝機



2000

- 發展半導體領域設備



2004

- 進駐高雄路竹科學園區
- PCB 檢查設備
- FPD 塗膠機



2008

- 發展LED領域設備
- 繞線設備



2010

- 成立昆山萬潤精機
- 成立萬潤慈善基金會



2013

- 發展SiP製程設備
- 在台研發中心創立

集團里程碑



2015

- 擴建第二期廠區
- PSA 貼合機

2016

- ACF/OCA 貼合機
- AOI - Info/CoWos

2017

- Wafer 等級 Underfill 點膠機

2018

- AGV
- AOI - 厚度量測設備
- 高精度電感繞線機
- 高精度電感包裝機

2020

- 晶圓級上下料機
- AOI - AI 六面檢查機
- Uniring - 自動機器人

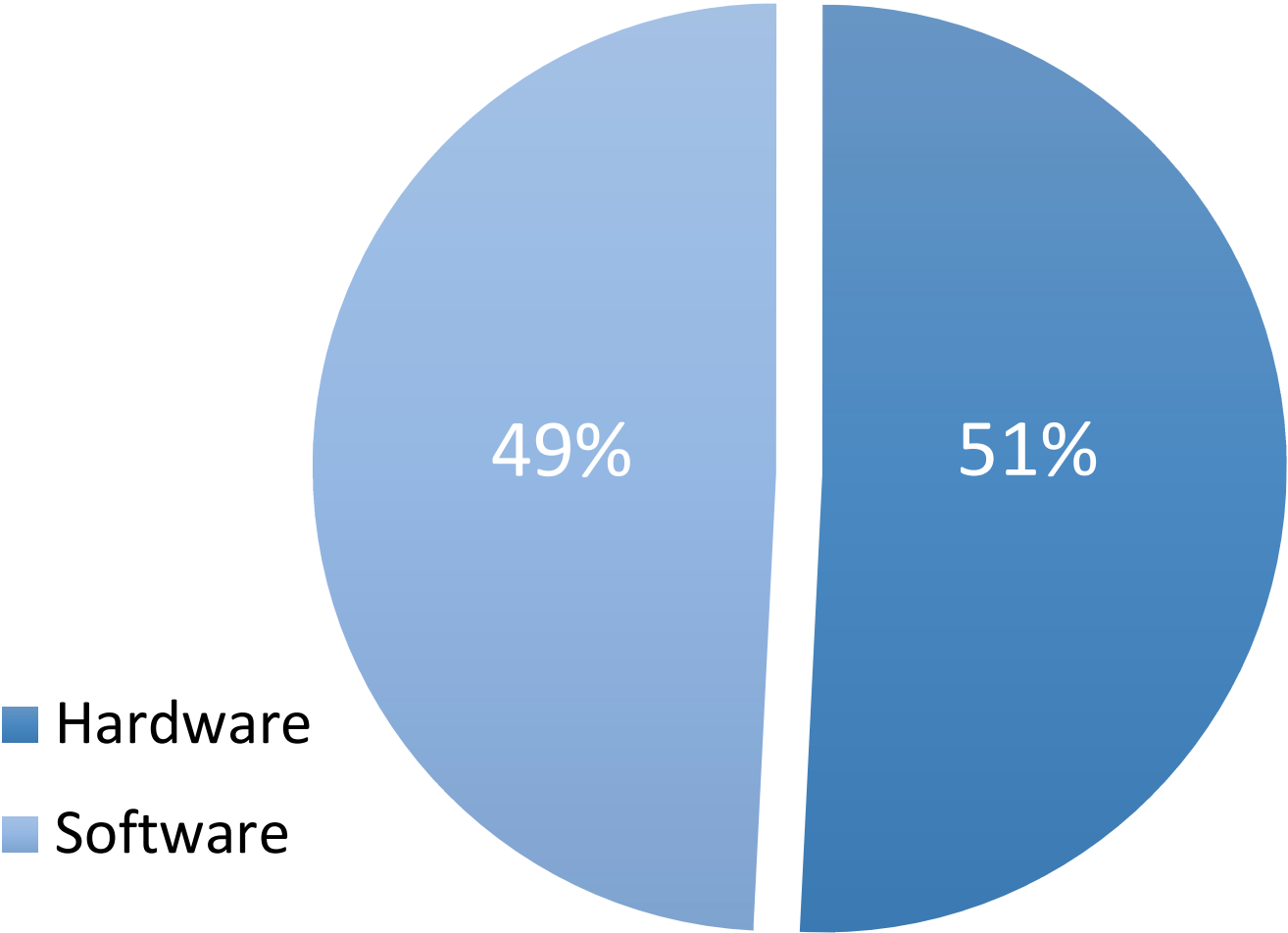
PRESENT

- 電容測試機
- 植球機

60%

研發人員在整體公司員工數的占比

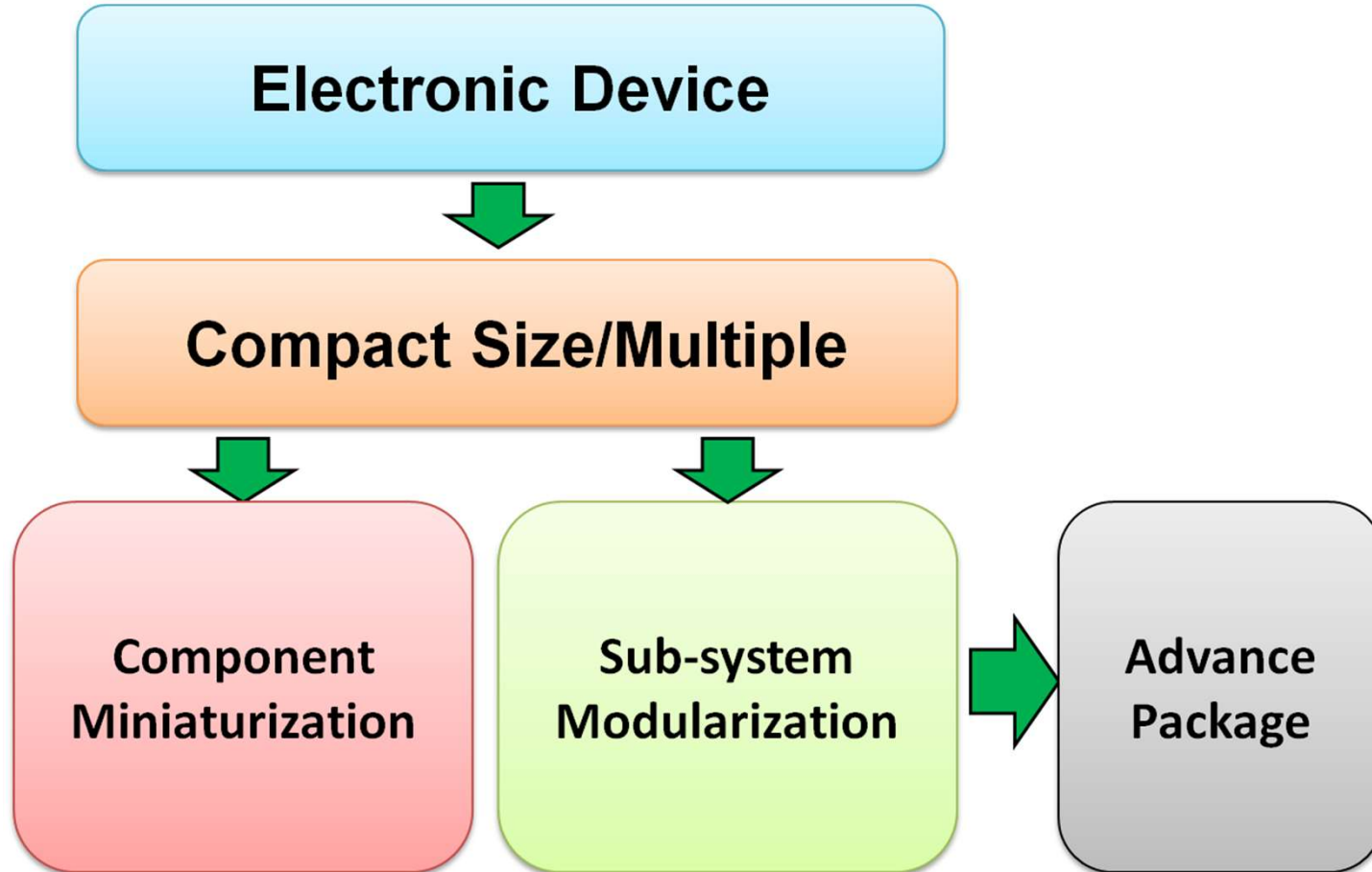
集團人力資源分佈



集團專利佈局

市場	已授予	申請中
半導體	113	21
被動元件	100	16
LED	41	5
機器人	12	2
TOTAL	266	44

Industry Overview



TSMC's 3D Fabric

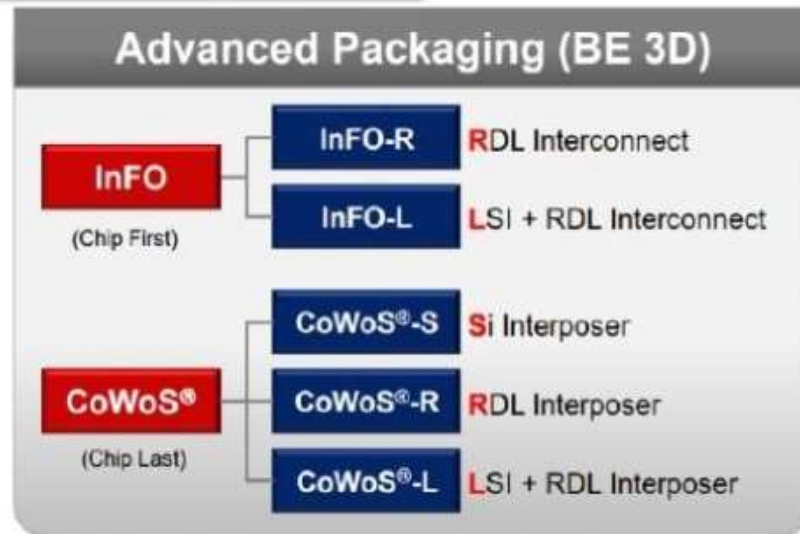
Packaging Type		Manufacturer		Application
SIP (system in package)		OSAT	ASE	Smart phone IoT Mobile
			USI	
		Module house	Hon Hai	
			Luxshare	
		Component	AAC	
			AMS	
3D Package	InFO,CoWoS	Foundry	TSMC	Smart Phone IoT Mobile
	SoIC		TSMC	
Flip chip	2D/2.5D	OSAT	ASE	Smart Phone IoT Mobile
			Spil	
			Amkor	
			Chipbond	
			Powertech	

Advance Package

TSMC 3DFabric™



SoIC: System on Integrated Chips



InFO: Integrated Fan-Out
CoWoS: Chip on Wafer on Substrate
RDL: Redistribution Layer
LSI: Local Si Interconnect

集團產品線



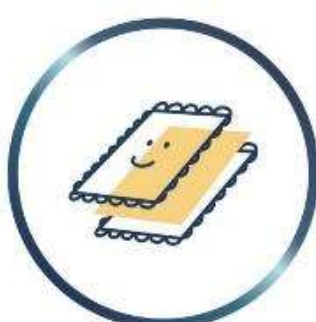
PC/LED 設備

切割機
電鍍機
測試機
繞線機
包裝機



自動化設備

收送料機
載板轉換機
分料機
分流機



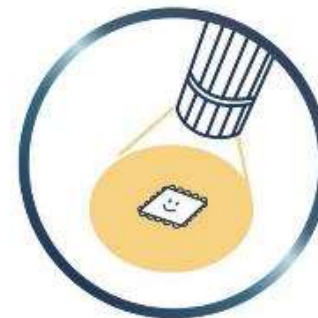
貼合設備

Flex
PSA
OCA



點膠設備

Underfill
Flux Jetting
銀膠機
Heatsink



AOI設備

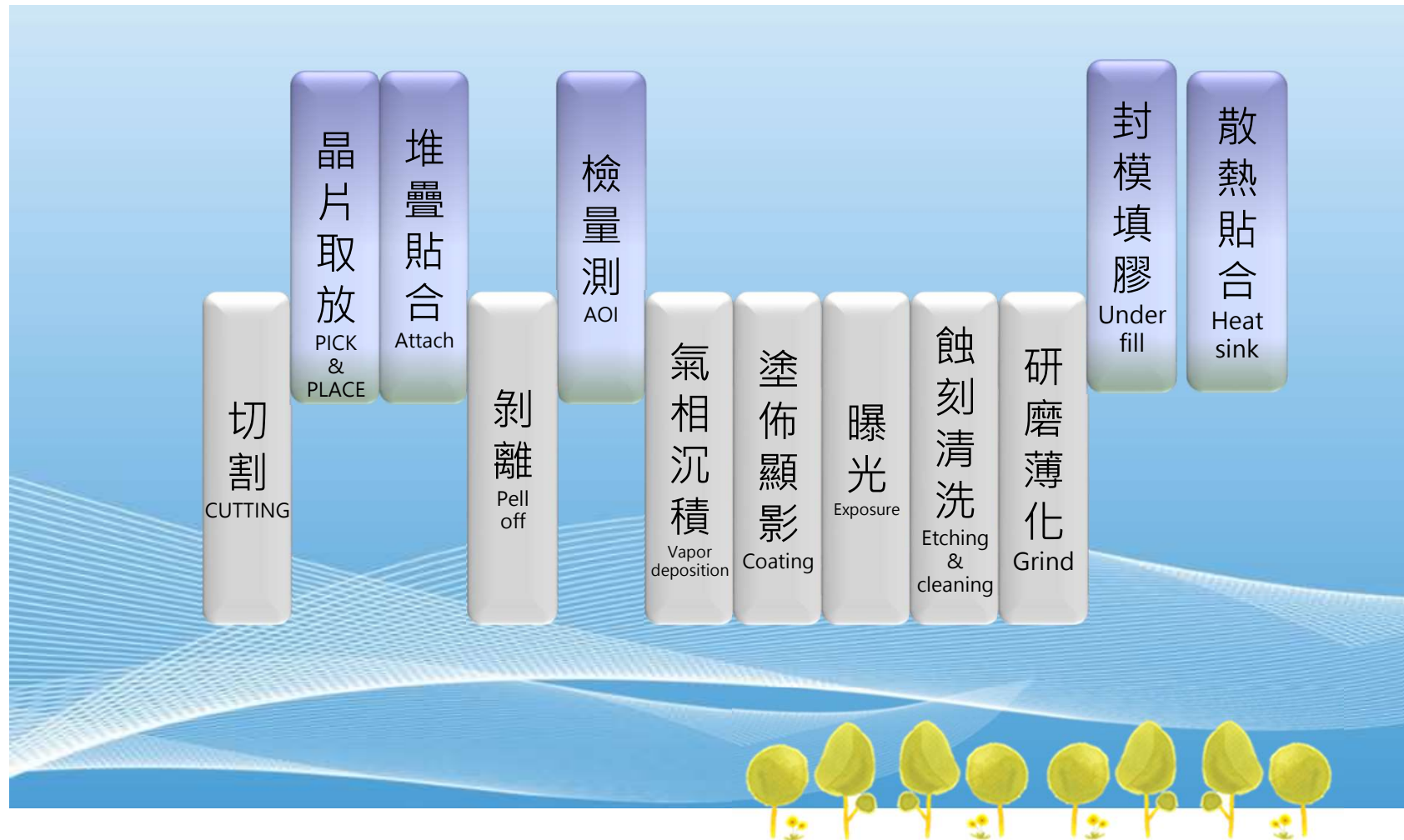
植晶後檢查
點膠後檢查
Bumping 後檢查
AOI 檢查與分選



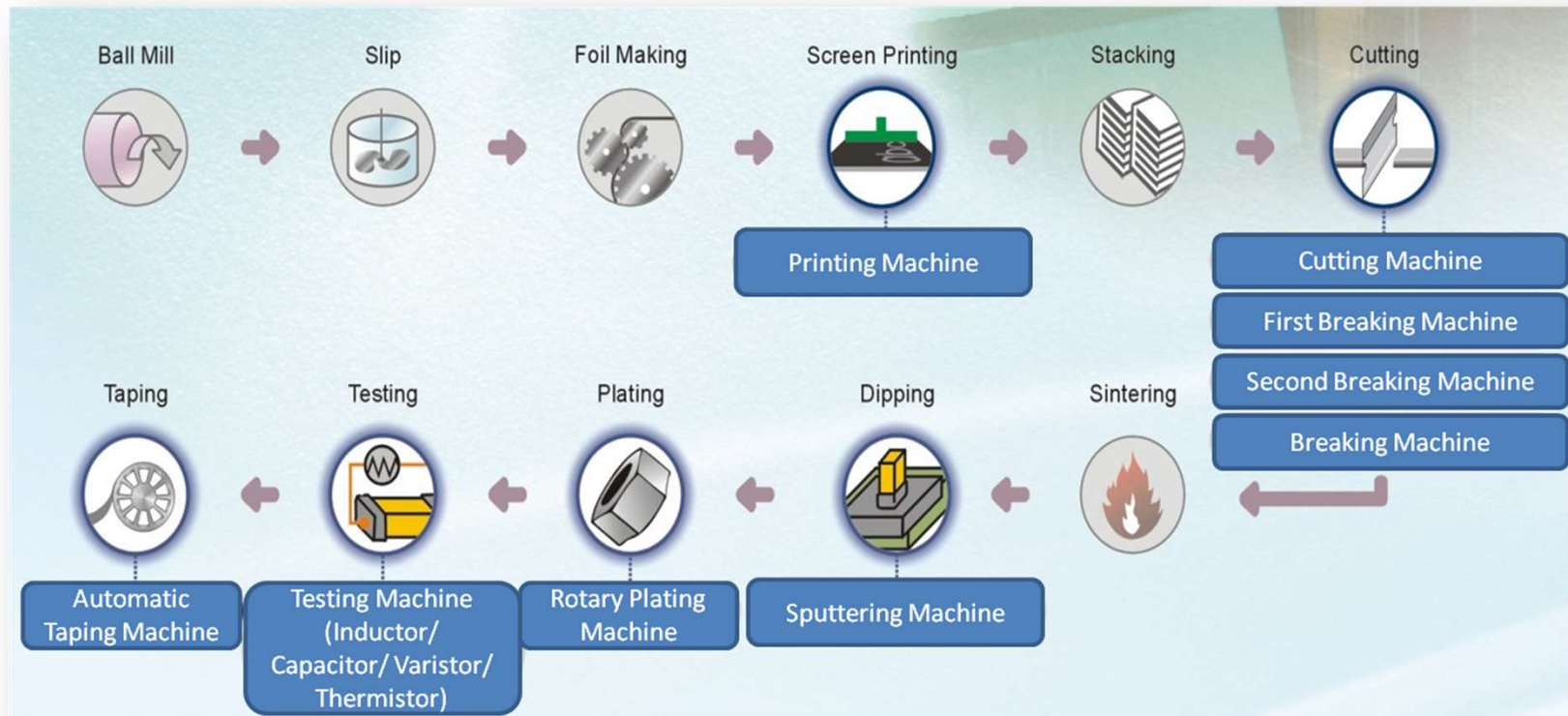
機器人系列

清潔機器人
巡檢機器人

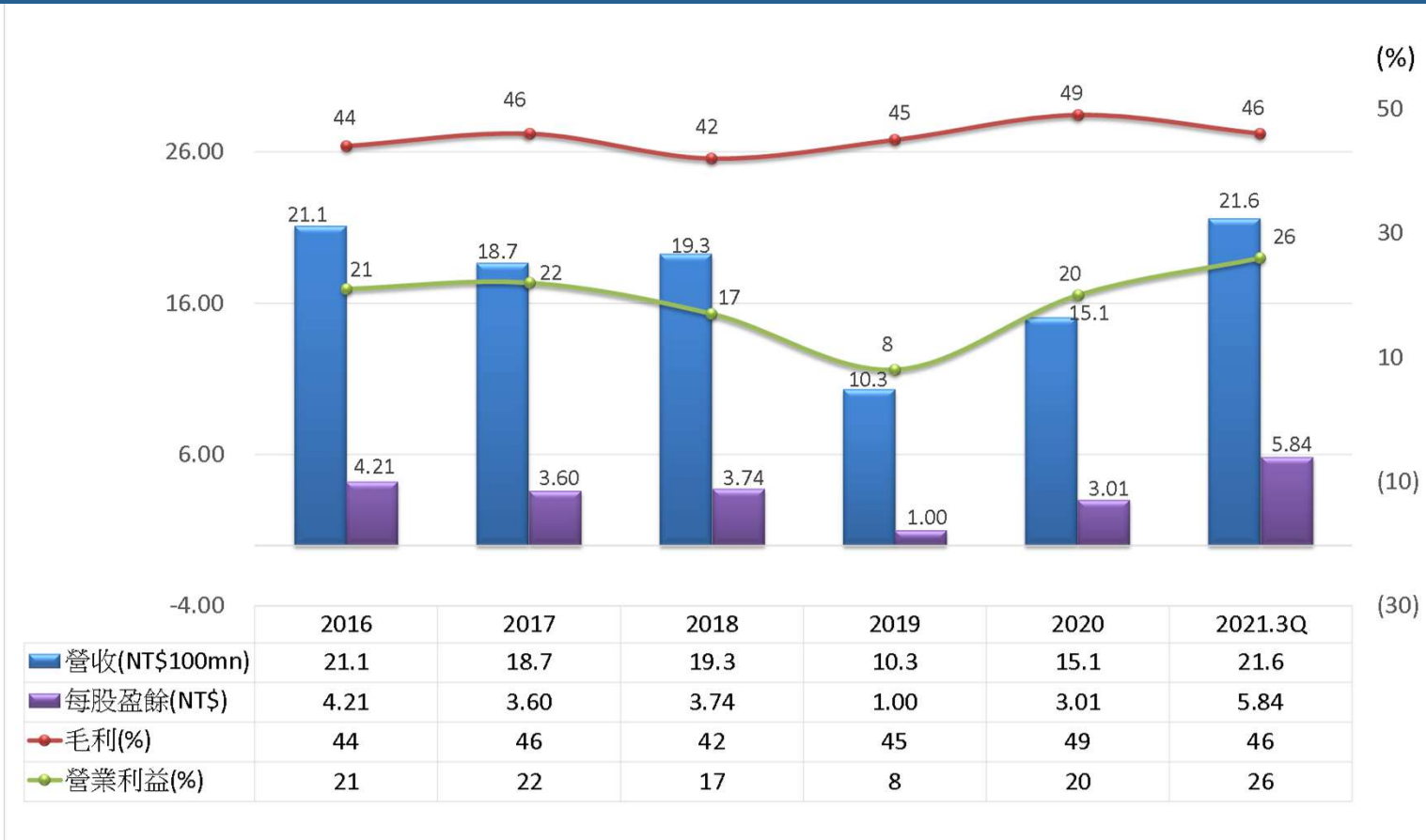
Allring in 3D Fabric Process



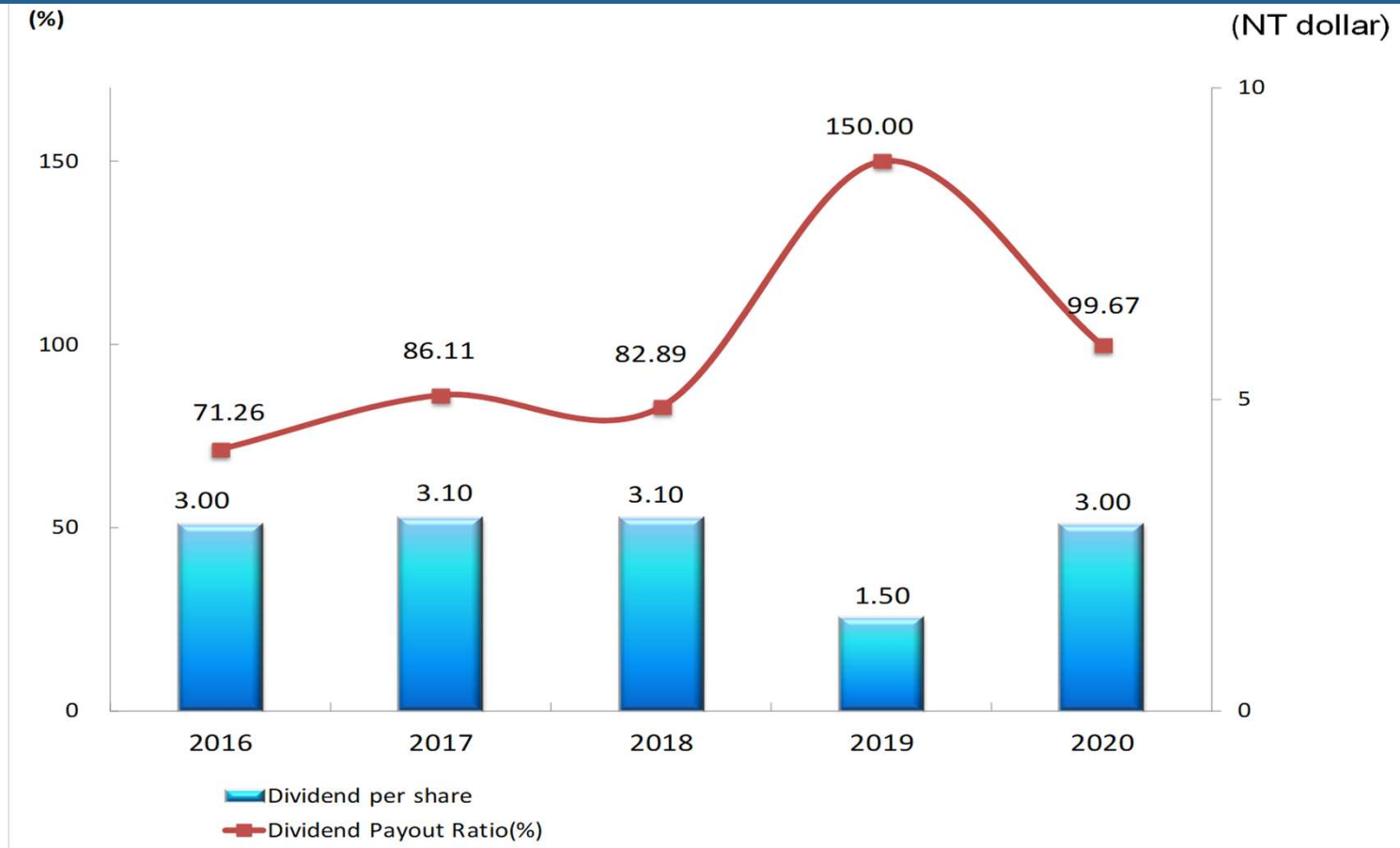
Passive Component Production Process



Financial Highlights



Financial Highlights





Thank you!